

FE-SEMによる半導体の各種バンプ接合部評価

金属、樹脂、複合材あらゆる材料の断面解析にご対応致します！

機械研磨

マイクローム

クライオイオンミリング
(IM4000:日立)

FIB
(SMI3050:日立(IFSII))



(IM4000)

FESEM/EDX/EBSD
(S4300SE:日立)

FESEM/EDX
(JSM6700F:JEOL)

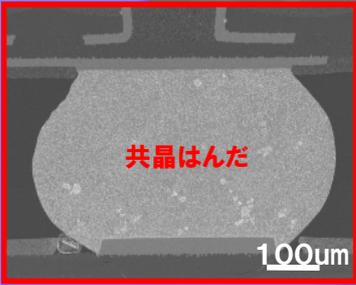
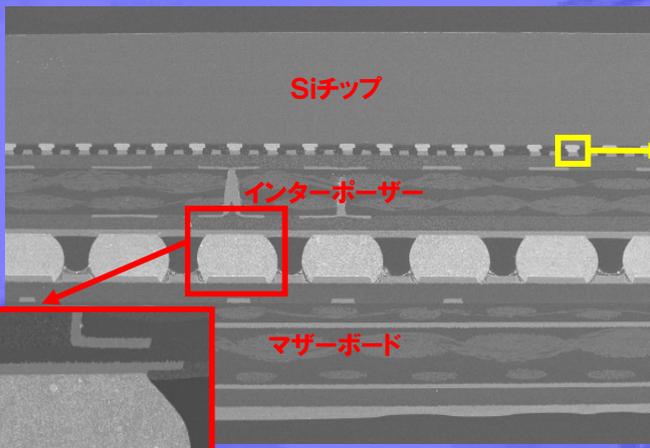
FESEM/EDX
(JSM6335F:JEOL)



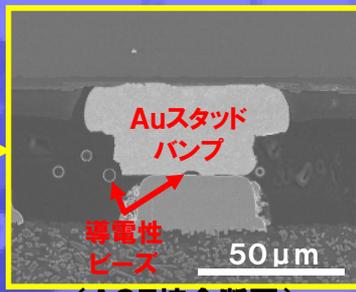
(S4300SE)

例えば
こんなことができます！

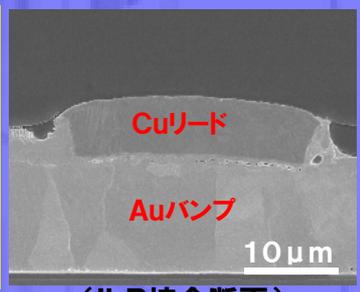
断面研磨加工→FE-SEM観察(半導体の各種バンプ接合部評価)



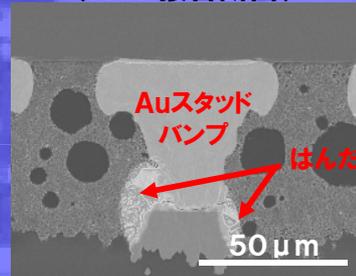
(アウターボール接合断面)



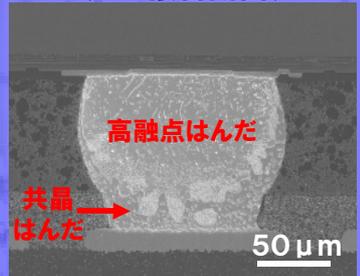
(ACF接合断面)



(ILB接合断面)

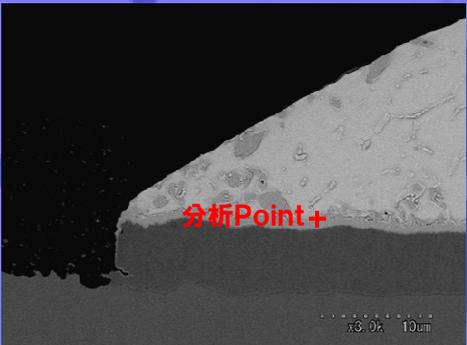


(Au-Sn接合断面)

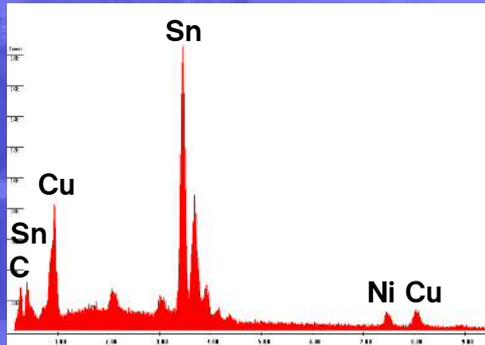


(ハンダボール接合断面)

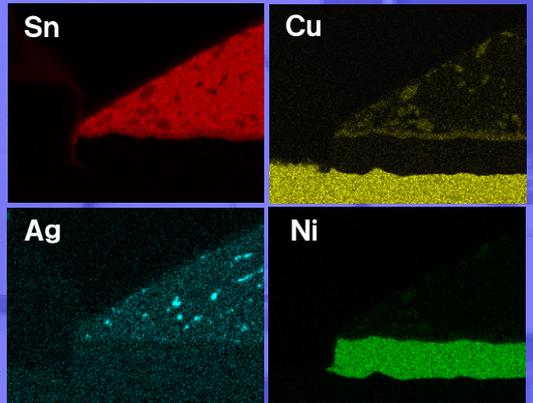
断面研磨加工→FE-SEM観察→EDX分析(はんだ化合物の元素分析)



(反射電子像)



(EDX点分析スペクトル)



(EDX元素マッピング)

反射電子像の組成コントラストを元素マッピングにより確認可能